PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-193939

(43)Date of publication of application: 03.08.1993

(51)Int.CI.

C01G 15/00 CO4B 35/00

(21)Application number: 04-250469

(22)Date of filing:

27.08.1992

(71)Applicant: TOSOH CORP

(72)Inventor: YAMAMOTO KAZUAKI

OGAWA NOBUHIRO KUMA KIMITAKA **MORI TAKASHI** YOSHIMURA RYOJI

(30)Priority

Priority number: 03244301

Priority date: 30.08.1991

Priority country: JP

(54) INDIUM OXIDE POWDER AND PRODUCTION OF ITO SINTERED BODY

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain indium oxide powder from which the high-density ITO sintered body is obtainable by atm. sintering by forming this powder into a fine and highly dispersed state specified in BET surface area, ratio between a BET diameter and a crystallite diameter and a primary particle size.

CONSTITUTION: The acicular indium hydroxide obtd. by adjusting the pH of a liquid mixture composed of an aq. In salt soln, and an aq. alkaline soln, to ≥7, then subjecting the mixture to maturing, filtering and drying treatments is calcined. The indium oxide powder product having 15 to 30m2/g BET surface area (A), ≤2 ratio (R) between the BET diameter and the crystallite diameter and ≤0.1μm average particle size (D) of the primary particle determined from a grain size distribution is obtd. The particles aggregate at area A <15m2/g and the primary particles are porous or too fine at area A >30m2/g. Either case, the high-density ITO sintered body is not yielded. The cohesion of the primary particles is strong, sintering activity degrades and the high-density sintered body is hardly yielded at ratio R>2. The primary particles aggregate and the high-density sintered body is hardly yielded at 0.1 µm diameter D.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

27.08.1999

Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3289335

[Date of registration]

22.03.2002

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-193939

(43)公開日 平成5年(1993)8月3日

(51)Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

C 0 1 C 15/00 C 0 4 B 35/00 B 7305-4G

R 8924-4G

審査請求 未請求 請求項の数3(全 5 頁)

(21)出願番号

特顯平4-250469

(22)出願日

平成 4年(1992) 8月27日

(31)優先権主張番号 特願平3-244301

(32)優先日

平3(1991)8月30日

(33)優先権主張国

日本(JP)

(71)出願人 000003300

東ソー株式会社

山口県新南陽市開成町4560番地

(72)発明者 山本 和明

山口県徳山市大字下上2140番地の8

(72)発明者 小川 展弘

山口県徳山市城ヶ丘二丁目10番10号

(72)発明者 隈 公貴

山口県新南陽市宮の前二丁目6番10号

(72)発明者 毛利 隆

山口県新南陽市土井二丁目15番 4-404号

(72)発明者 吉村 了治

山形県山形市城南町三丁目2番25-412号

(54)【発明の名称】 酸化インジウム粉末及びITO焼結体の製造方法

(57)【要約】

BET表面積が、15m²/g以上、3 【構成】 Om² /g以下、BET径と結晶子径の比が2以下、粒 度分布測定より求めた一次粒子の平均粒子径が 0.1 μ m以下である酸化インジウム粉末、及びこの粉末と酸化 スズとを混合、焼結してなるITO焼結体の製造方法。 得られる酸化インジウム粉末は微細で高

分散な粉末であり、この粉末を用いることにより、常圧 焼結で高密度なITO焼結体を製造することができる。 この焼結体はスパッタリングターゲット材として優れた 特性を有する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 BET表面積が、15m²/g以上、3 Om² /g以下、BET径と結晶子径の比が2以下、粒 度分布測定より求めた一次粒子の平均粒子径が 0.1 μ m以下である酸化インジウム粉末。

【請求項2】 インジウム塩水溶液とアルカリ水溶液を 混合し、該混合溶液の p Hを 7以上にした後、熟成、濾 過、乾燥処理して得られる針状水酸化インジウムを仮焼 することを特徴とする酸化インジウム粉末の製造方法。

【請求項3】 請求項1に記載の酸化インジウム粉末 に、酸化スズ粉末を混合し、成形し、焼結することを特 徴とする焼結密度 6.0 g/c m³以上のITO焼結体 の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、酸化インジウム粉末及 びそれを用いたITO焼結体に関するものである。IT O焼結体は、ITOターゲットとして主に用いられてお り、透明導電膜形成材料として、広く知られている材料 である。

[0002]

【従来の技術】近年、太陽電池や液晶ディスプレイ透明 電極やタッチパネルなどに用いる透明導電膜として、I TO薄膜の需要が増大している。このようなITO薄膜 を形成する方法には、ITO微粒子を基材に塗布する方 法、IT合金ターゲットあるいはITO焼結体ターゲッ トのスパッタリング、もしくは真空蒸着法により基材面 にITO膜を形成させる方法などが知られているが、現 在では特にITO焼結体のスパッタリング法が高性能な 膜が得られることから一般的となっている。

【0003】工業的にスパッタリング成膜を行う場合、 スパッタ操作性が優れていることが好ましく、スパッタ レートの増大、ターゲット表面に生成する黒色のノジュ ール発生の防止、熱衝撃等による割れの防止等の改善が 望まれている。

【0004】又、近年、ITO透明導電膜の高性能化が 望まれているなか、特に低温基板上に低抵抗なITO透 明導電膜の形成技術の開発が熱望されている。例えば、 液晶のカラー化、表示素子の微細化、アクティブマトリ ックス方式の採用、TFT、MIMの導入に伴い、より 低温の基板上に低抵抗な透明導電膜を形成する必要性が 増大している。

【0005】これまでに、ITOターゲットを高密度化 すれば、上記のようなスパッタの操作性、低温成膜特性 が向上することが知られている。

【0006】通常、ITO焼結体は、酸化インジウム粉 末と酸化スズ粉末の混合粉末(ITO粉末)を加圧成型 後焼結して製造されている。酸化インジウムのみでは、 1000℃付近から焼結し、比較的易焼結性であるが、

焼結しにくくなり、一般的な常圧焼結法では高密度な焼 結体を得ることは、非常に困難である。

【0007】これまで、酸化インジウム粉末を仮焼し、 平均粒径3~6μmの酸化インジウムとし、これと酸化 スズとを混合して用いる方法(例えば、特開昭62-2 1751号公報等)、共沈ITO粉末を焼結体原料に用 いる方法(例えば、特開昭62-12009公報等)等 が提案されているが、理論密度(7.15g/cm゚) の70% (5g/cm³) 程度で、十分に高密度とはい 10 えない。

【0008】一方、常圧焼結法以外の特殊な焼結法が幾 つか提案されているが、必ずしも満足のいくものではな い。例えば、ホットプレス法(例えば、特開昭56-5 4702公報等)は、ターゲット表層部分が還元される ため期待されたスパッタ特性を示さず、さらに、製造コ ストが高く、経済性に乏しい。又、酸素加圧焼結法によ り、高温で高密度ITOターゲットを製造する方法が提 案されているが (例えば、特開平3-207858公報 等)、装置コストが高く、又、1600℃以上の高温焼 結のため、焼結体が異常粒成長を起こしやすく、ターゲ ットの熱衝撃性等に問題を生じる可能性がある。

[0009]

20

40

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、微細 で高分散状態の酸化インジウム粉末を提案するものであ り、この粉末を用いることにより常圧焼結で得られる 6.0g/cm³以上の高密度ITO焼結体の製造法を 提案するものである。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、常圧焼結 でITO焼結体を製造する際の酸化インジウム粉末に関 し、鋭意検討した結果、ITO焼結体の密度は、酸化イ ンジウムの物性に依存することを見出し、本発明を完成 するに至った。

【0011】即ち、本発明は、BET表面積が、15m /g以上、30m²/g以下、BET径と結晶子径の 比が2以下、粒度分布測定より求めた、一次粒子の平均 粒子径が 0. 1 μ m以下である酸化インジウム粉末、及 び、該酸化インジウム粉末に、酸化スズ粉末を混合し、 成形し、焼結することを特徴とする焼結密度6.0g/ c m 。以上の I T O 焼結体の製造方法に関するものであ る。

【0012】以下、本発明を詳細に説明する。

【0013】常圧焼結で高密度ITO焼結体を得るため には、原料の酸化インジウム粉末は、微細で高分散な粒 子特性が必要である。

【0014】本発明の酸化インジウム粉末は、BET表 面積が、15m² /g以上、30 m² /g以下であるこ とが必要である。BET表面積が、15m²/g未満の 場合は、粒子が凝集しており、高密度のITO焼結体を ITO粉末では難焼結性の酸化スズが焼結阻害剤となり 50 与えることはできない。又、30m²/gを越える粒子

は、一次粒子が多孔質であるか、又は、粒子が微細すぎ て、高密度な焼結体を与えることが困難となる。

【0015】本発明の酸化インジウム粉末は、BET径 と結晶子径の比(BET径/結晶子径)が2以下である ことが必要である。特に、1.5以下が好ましい。BE T径と結晶子径の比の下限は、約1であり、この時一次 粒子は、単結晶に近い状態と考えることができる。結晶 子径は、200~600オングストロームの範囲が好ま しく、BET径は、300~1000オングストローム の範囲が好ましい。 BET径と結晶子径の比が 2 を越え ると、一次粒子の凝集状態が強く、焼結活性が低下し、 高密度の焼結体を与えることが困難となる。

【0016】なお、結晶子径の大きさは、酸化インジウ ムのXRD測定による(222)の回折ピークの半値幅 から求めることができる。又、BET径は、粉末のBE T値を測定し、粒子を球に近似して求めた値である。

【0017】本発明の酸化インジウム粉末は、粒度分布 測定より求められる一次粒子の平均粒子径が、0.1μ m以下であることが必要である。一次粒子の平均粒子径 が 0.1μ mを越えると、一次粒子が凝集しており、高 密度の焼結体を与えることが困難となる。

【0018】粒度分布測定による一次粒子の平均粒子径 は、以下のように求められる。即ち、粒子を水溶液中で 十分に分散処理を行い(例えば、少量の分散剤を添加 し、超音波で1時間以上分散)、0.12μm以下の粒 度分布測定により平均粒子径を求める。なお、同一の分 散処理を施した粒度分布測定により、二次粒子の平均粒 径も求めることができるが、平均粒径は0.5μm以下 の微細な粒子である。

【0019】次に、本発明の酸化インジウム粉末を与え 30 る好ましい実施態様を説明する。酸化インジウム粉末 は、インジウム塩水溶液とアルカリ溶液を混合して、該 溶液のpHを7以上にした後、熟成、濾過、乾燥処理し て得られる針状水酸化インジウムを仮焼することによ り、得ることができる。

【0020】インジウム塩水溶液には、例えば硝酸イン ジウム溶液や硫酸インジウム溶液を用いることができ る。アルカリ溶液には、アンモニア水や、水酸化ナトリ ウム等の水溶液を用いることができる。例えば、0.0 1~2mol/Lの硝酸インジウム溶液にアンモニア水 40 を添加し、pH7以上で水酸化インジウム粒子を沈殿さ せることができる。

【0021】反応温度は特に限定はないが、一般に室温 から90℃の範囲で実施できる。均一な反応を行うため に、攪拌することが一般的である。

【0022】得られた水酸化インジウムスラリーの均一 性、分散性を向上させるために、熟成操作を加えること が必要である。熟成とは、当該スラリーをその反応系に おいて、保持することを言う。熟成時の条件は特に限定 されないが、攪拌状態で、70℃以上の温度で数時間以 50 上保持することが好ましい。熟成により、反応不十分な 状態の水酸化インジウム微粒子が消滅し、分散性の良い 針状微粒子を得られ、微細で高分散な酸化インジウム粉 末を与える前駆体となる。

4

【0023】熟成した水酸化インジウムスラリーは、固 液分離した後、乾燥する。乾燥温度は、90~260℃ の範囲で実施することができる。乾燥ケークは、仮焼前 に軽く解砕される。

【0024】解砕した水酸化インジウム粉末は、仮焼 し、酸化インジウム粉末とする。仮焼温度は、600~ 1050℃、特に650~950℃が好ましい。乾燥温 度が低すぎると、一次粒子が多孔状態で、例えばBET 表面積が30m²以上となったり、又、仮焼温度が高す ぎると、BET表面積が15m² 未満となったりして、 本発明の酸化インジウム粉末を与えることができない場

【0025】本発明は、密度6.0g/cm³以上、さ らに好ましくは6. 4 g/cm³ (相対密度90%以 上)のITO焼結体の製造方法を与えるものである。即 ち、本発明で開示した、微細で高分散な酸化インジウム 粉末に、酸化スズ粉末を混合し、成型し、焼結すること により、密度6.0g/cm³以上、さらに好ましくは 6. 4g/cm°のITO焼結体を得ることができる。 【0026】混合する酸化スズ粉末としては、例えばB ET比表面積が3~20m²/gが用いられる。酸化ス ズの混合量は、3~15 w t %が好ましい。

【0027】次にITO粉末を成型する。成型方法とし ては、目的とした形状に合った成型方法を選べばよく、 金型成型法、鋳込み成型法等例示されるが特に限定され ない。

【0028】焼結体の高密度化のために、成型体は冷間 静水圧プレス (СІР) にて加圧処理することが好まし い。必要に応じて、CIP処理を2~5回程度繰り返し ても良い。

【0029】成型体の焼結温度は1250℃以上160 0℃以下で特に好ましくは1350℃以上1550℃以 下の範囲である。焼結温度が1250℃未満の場合、密 度が6.0g/cm[®]未満である焼結体が得られたり、 また、焼結温度が1600℃を越える場合、スズ成分の 蒸発や、焼結粒径の異常な成長が起こり、安定した製造 が困難となる場合がある。焼結時間は、数時間から数十 時間が好ましく、焼結雰囲気としては、特に限定されず 大気中で十分であるが、酸素中、真空中、不活性ガス中 等のいずれの条件でも良い。

【0030】本発明より得られるITO焼結体は以下の 様な特性を具備する。焼結体の焼結粒径は、1μm以上 20μm以下であり、焼結体の比抵抗は、7.0×10 Ω c m以下である。抗折力は、10 k g / m m²以 上を達成することができる。このような焼結体は、スパ ッタリングターゲット材として用いた場合、成膜速度が

速く、スパッタ成膜中、安定な放電が可能であり、ター ゲット表面に生成する黒色のノジュール発生が抑制さ れ、さらには、低温成膜特性に優れている。

[0031]

【発明の効果】本発明の酸化インジウム粉末は、微細で 高分散な粉末であり、該酸化インジウム粉末を用いるこ とにより、常圧焼結で、高密度ITO焼結体を製造する ことができる。

【0032】このITO焼結体をスパッタリングターゲ ット材として使用すれば、優れたスパッタリング特性を 10 有するものとなり、その工業的価値は極めて高いもので ある。

[0033]

【実施例】以下、実施例により本発明を更に具体的に説 明するが、本発明はこれに限定されるものではない。

【0034】実施例1

インジウムイオン濃度 0.5 mol/Lの硝酸インジウ ム溶液を調製し、温度85℃で、攪拌しながら14vo 1. %のアンモニア水を約30分間添加し、水酸化イン*

表 1

*ジウムスラリーを析出させ、pH8に調製した。その 後、同一の温度、攪拌条件で、10時間、該スラリーを 熟成した。熟成した水酸化インジウムを濾過、洗浄後、 110℃で乾燥した。この水酸化インジウムを700℃ で4時間仮焼し、酸化インジウム粉末を得た。得られた 酸化インジウム粉末は、BET表面積25m゚/g、B ET径330オングストローム、結晶子径270オング ストロームで、BET径と結晶子径の比が約1.2であ り、一次粒子は0. 08 μ m であった。

【0035】この酸化インジウム粉末と酸化スズ粉末を 混合し (酸化スズ:10wt%)、金型プレスで加圧成 型し、さらにСІР(2 t / c m²)処理した後、常圧 大気中で1400℃で焼結させた。焼結体は80φの径 であり、焼結密度は6.8g/cm゚ (95%) であっ

【0036】この焼結体をターゲット材として用いて、 表1の条件でスパッタリングテストを実施した。

[0037]

スパッタ方式	DCマグネトロンスパッタリング
基板温度	120℃~300℃
ターゲット基板間距離	4 0 mm
ガス圧	3×10 ⁻³ Torr
スパッタガス	アルゴン
投入電力	3 3 W
膜厚	2000オングストローム
基板	コーニング#7059ガラス

【0038】得られた膜の比抵抗は、基板温度が300 $^{\circ}$ C、200 $^{\circ}$ C、120 $^{\circ}$ Cでそれぞれ1.8×10 $^{-1}$ $^{\circ}$ mであった。

【0039】実施例2

BET表面積が15m²/g、BET径560オングス トローム、結晶子径380オングストローム、結晶子径 とBET径の比が約1.5、一次粒子が0.09μmの 酸化インジウム粉末を用いて、実施例1と同様に、酸化 スズ粉末を混合し、スリップキャスト成型法を用いて成 型した後、1400℃で焼結した。得られたITO焼結 体の焼結密度は6.4g/cm³(90%)であった。 【0040】実施例3

BET表面積20m²/g、BET径420オングスト ローム、結晶子径300オングストローム、結晶子径と cm、2.2×10⁻⁴ Ωcm、2.4×10⁻⁴ Ωc 40 BET径の比が1.4、一次粒子の粒度分布が、0.0 7μmである酸化インジウム粉末と、酸化スズ粉末を混 合した(酸化スズ:5wt%)。調製したITO粉末を 金型プレスで加圧成型し、さらにCIP(5t/c m¹) 処理した後、常圧大気中で1500℃で焼結させ た。焼結体は80φの径であり、焼結密度は7.0g/ cm³ (98%) であった。

【0041】比較例1

実施例1と同様に水酸化インジウムスラリーを調製し、 熟成することなく、実施例1と同様な操作で酸化インジ 50 ウム粉末を調製した。得られた酸化インジウム粉末は、

BET表面積13m²/g、BET径640オングスト ローム、結晶子径360オングストローム、BET径と 結晶子径の比は1.8、一次粒子は1.0μmであっ た。得られた酸化インジウム粉末を実施例1と同様の操 作で焼結したところ、焼結密度は、5.8g/cm (81%) であった。

【0042】この焼結体をターゲット材料として、実施 例1と同一の条件でスパッタリングした。

【0043】得られた膜の比抵抗は、基板温度が300 c m, 2. 7×10^{-4} Ω c m, 3. 8×10^{-4} Ω c mであった。

【0044】比較例2

BET表面積40m²/g、BET径210オングスト ローム、結晶子径200オングストローム、結晶子径と BET径の比が約1、一次粒子が、0.09μmである 酸化インジウム粉末と、酸化スズ粉末を混合した(酸化 スズ:10wt%)。調製したITO粉末を金型プレス で加圧成型し、さらにCIP (5 t / c m²) 処理した 後、常圧大気中で1500℃で焼結させた。焼結体は8 0 φの径であり、焼結密度は5.7 g/c m³(80 %) であった。

【0045】比較例3

BET表面積10m²/g、BET径840オングスト ローム、結晶子径500オングストローム、結晶子径と \mathbb{C} 、200 \mathbb{C} 、120 \mathbb{C} でそれぞれ2.0 \times 10 $^{-1}$ Ω 10 BET径の比が1.7、一次粒子が、1.0 μ mである 酸化インジウム粉末と、酸化スズ粉末を混合した(酸化 スズ: 10wt%)。調製したITO粉末を金型プレス で加圧成型し、さらにCIP(5 t / c m²) 処理した 後、常圧大気中で1500℃で焼結させた。焼結体は8 0 φの径であり、焼結密度は5.8g/cm³(81 %) であった。